

2026.09

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

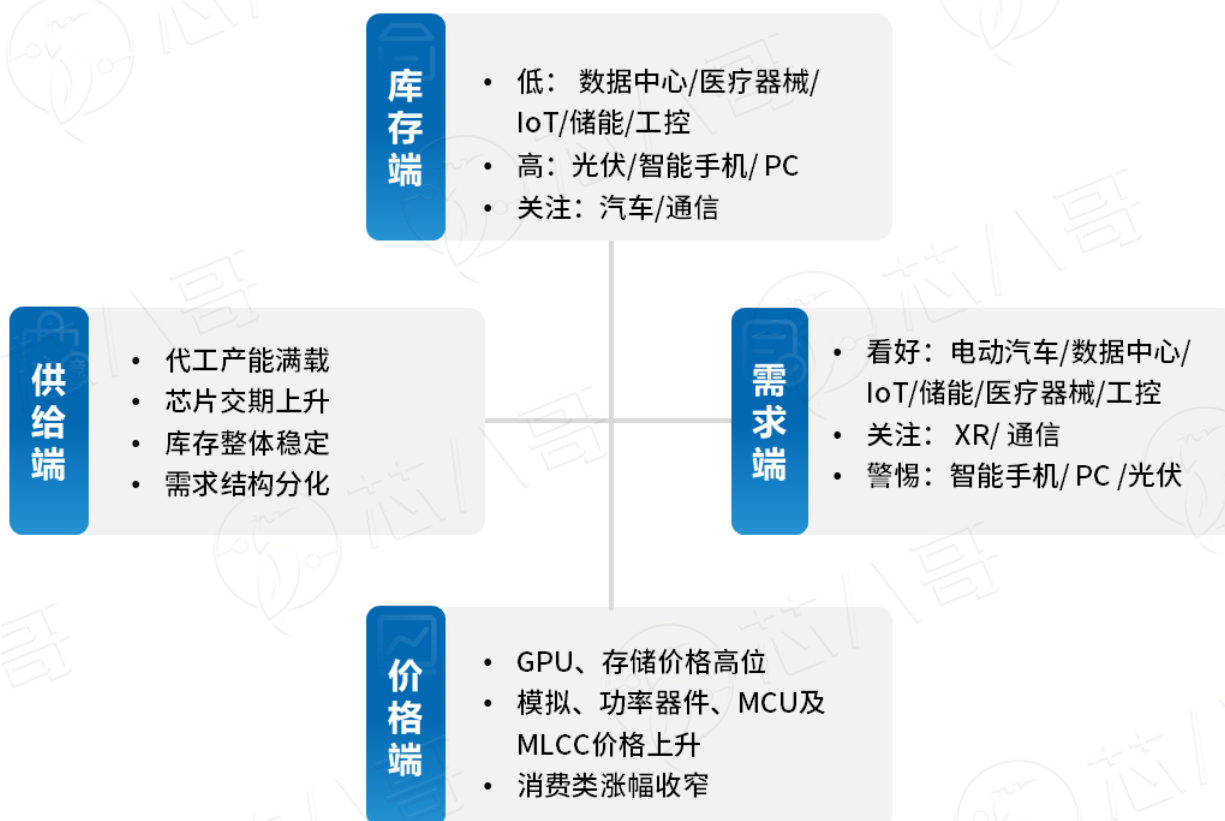
序章	1
一、宏观经济	1
1、全球制造业扩张加速，复苏动能增强	1
2、电子信息制造业快速增长，效益稳定	2
3、半导体销售保持强劲，累计超万亿美元	3
二、芯片交期趋势	5
1、整体芯片交期趋势	5
2、重点芯片供应商交期一览	6
三、订单及库存情况	17
四、半导体供应链	19
1、半导体上游厂商	19
(1) 硅晶圆/设备	19
(2) 原厂	20
(3) 晶圆代工	23
(4) 封装测试	24
2、分销商	24
3、系统集成	25
4、终端应用	29
(1) 消费电子	29
(2) 新能源汽车	31
(3) 工控	33
(4) 光伏	35
(5) 储能	35
(6) 数据中心	36
(7) 通信	37
(8) 医疗器械	39
五、分销与采购机遇及风险	40
1、机遇	40
2、风险	41
六、小结	42
免责声明	43

图表目录

图表 1：全球主要经济体制造业 PMI	2
图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况.....	2
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速.....	3
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速.....	4
图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速.....	4
图表 6：费城及申万半导体指数走势.....	5
图表 7：芯片交期趋势.....	6
图表 8：主要厂商交期及趋势一览.....	6
图表 9：头部企业订单及库存情况.....	17
图表 10：半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况	19
图表 12：主要原厂最新动态	20
图表 12：主要晶圆代工厂最新动态	23
图表 13：主要封测厂商最新动态	24
图表 14：主要元器件分销商最新动态	25
图表 15：主要系统集成商最新动态	26
图表 16：消费电子厂商最新动态	30
图表 17：新能源汽车厂商最新动态	32
图表 18：工控厂商最新动态	33
图表 19：光伏厂商最新动态	35
图表 20：储能厂商最新动态	36
图表 21：数据中心厂商最新动态	36
图表 22：通信厂商最新动态	38
图表 23：医疗器械厂商最新动态	39
图表 24：细分市场机会关注	40
图表 25：细分市场风险预警	41

序章

涨价全面落地

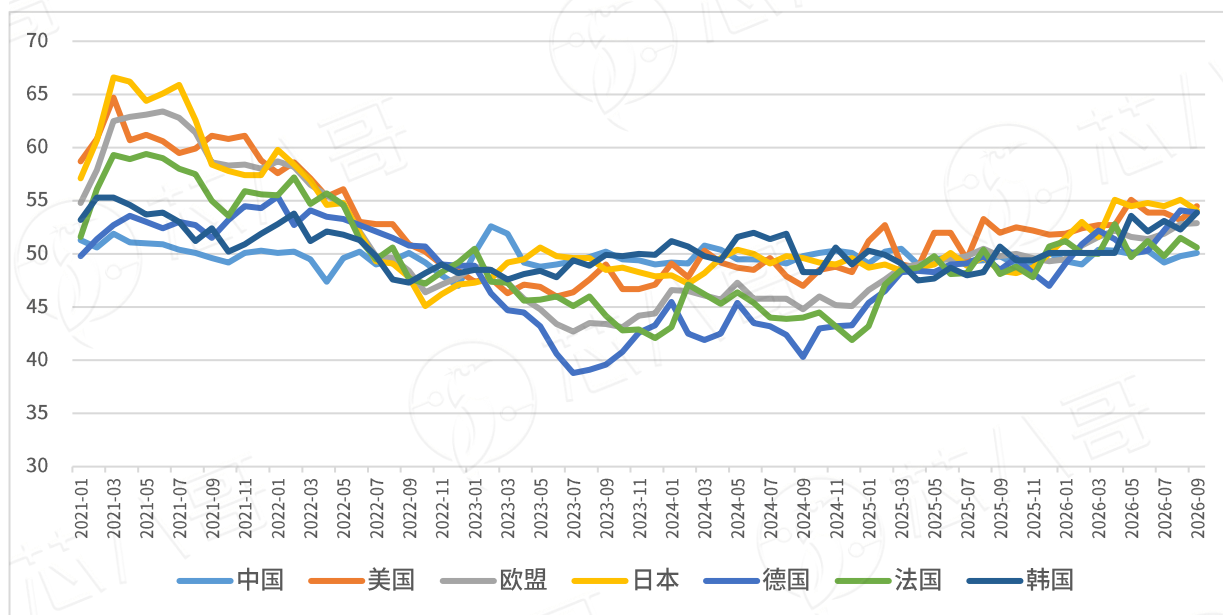


一、宏观经济

1、全球制造业扩张加速，复苏动能增强

9月，全球制造业 PMI 回升至 53.0，创 55 个月新高。AI 算力链驱动下以中日韩为代表的东亚半导体经济带表现最为强劲，欧盟地区实现四年多来首次全员扩张，但美国成本压力重新积聚、法国扩张势头放缓，全球制造业复苏的均衡性仍有待观察。

图表 1：全球主要经济体制造业 PMI

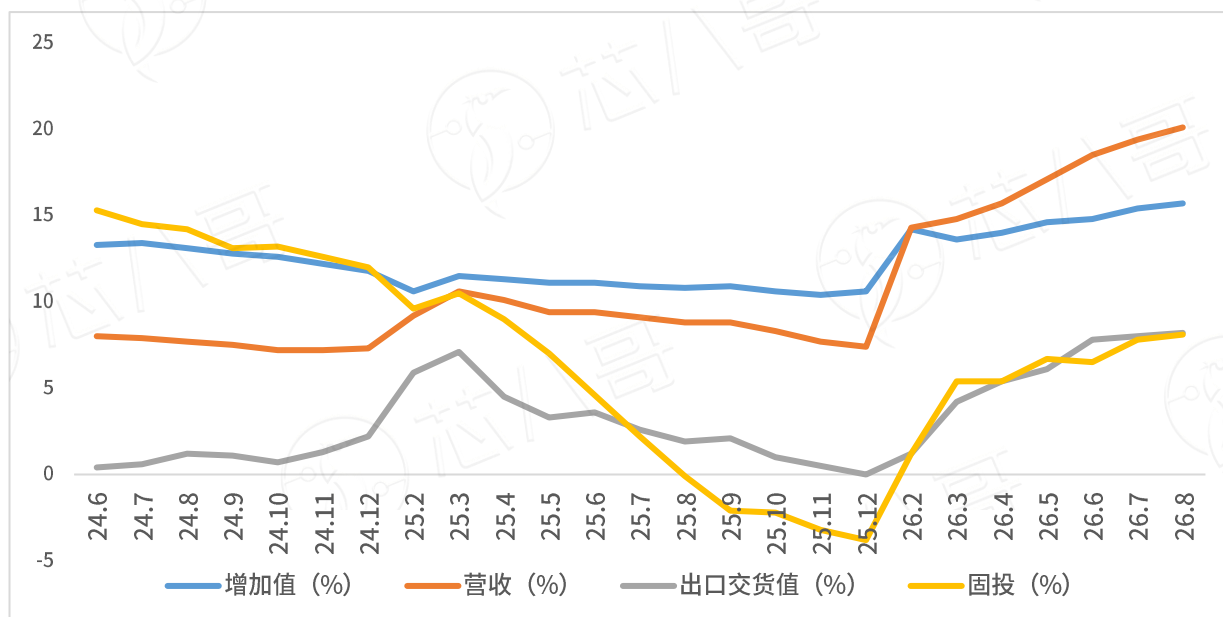


资料来源：国家统计局、芯八哥整理

2、电子信息制造业快速增长，效益稳定

2026 年 1-8 月，中国电子信息制造业生产快速增长，出口持续上行，效益改善态势稳固，投资保持稳步增长，行业整体发展态势良好。

图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况

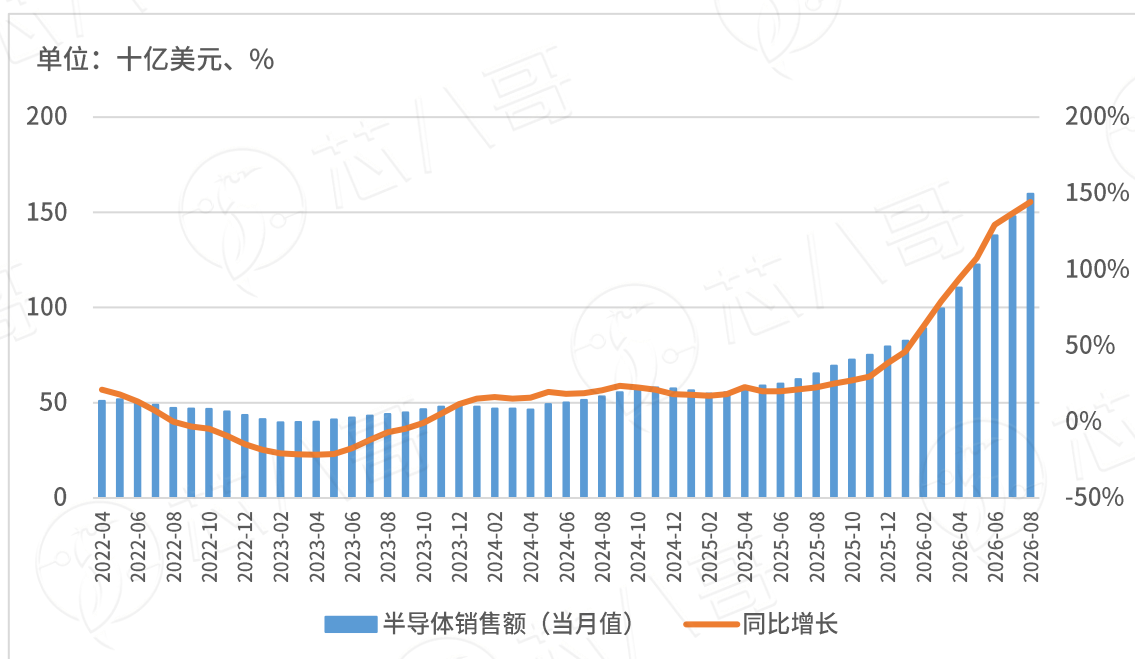


3、半导体销售保持强劲，累计超万亿美元

根据 SIA 最新数据,8月全球半导体市场销售额达 1597.4 亿美元,同比增长 144.3%,连续第 18 个月实现环比增长, 1-8 月累计销售额超 1 万亿美元。

区域市场方面,美洲市场同比增长 180.9%,中国市场同比增长 131.3%,亚太地区、日本和欧洲销售额分别为 143.0%、62.3%、98.5%,美洲、亚太地区及中国市场推动全球半导体产业持续扩张。

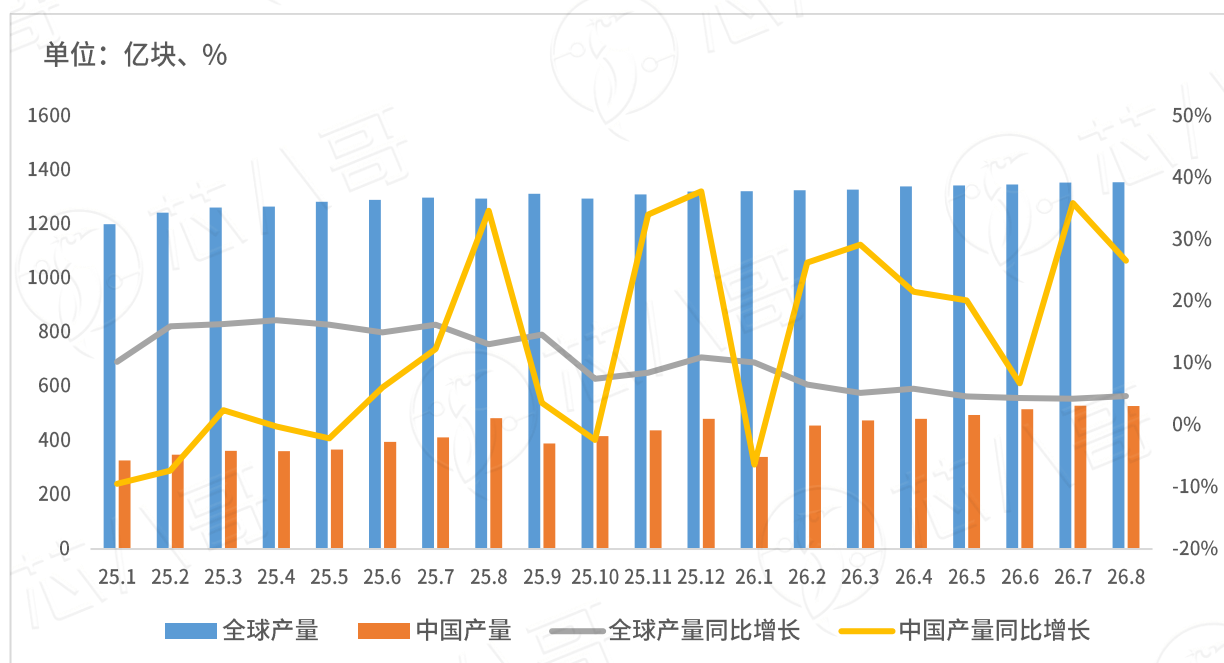
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看, 8月全球与中国集成电路产量分别约 1356、529 亿块, 中国产能规模持续扩张。

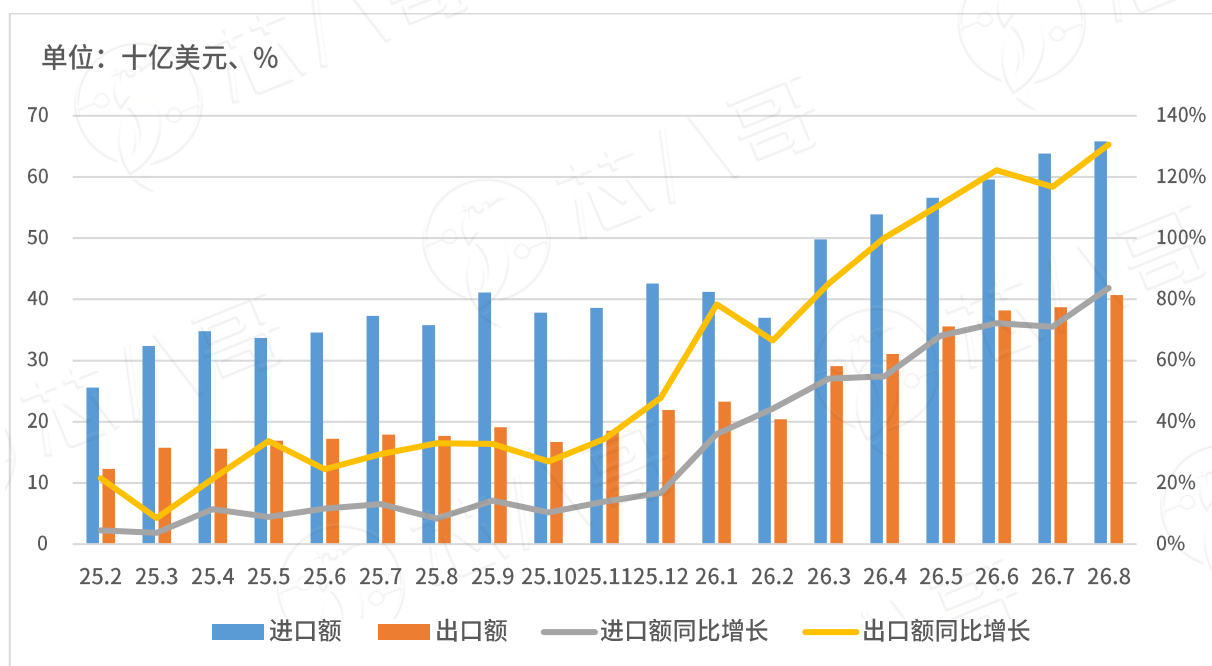
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速



资料来源：国家统计局、CSIA、SIA、芯八哥整理

进出口方面，8 月中国集成电路贸易保持强劲，出口增速超 130%，产品结构向高附加值方向持续升级。

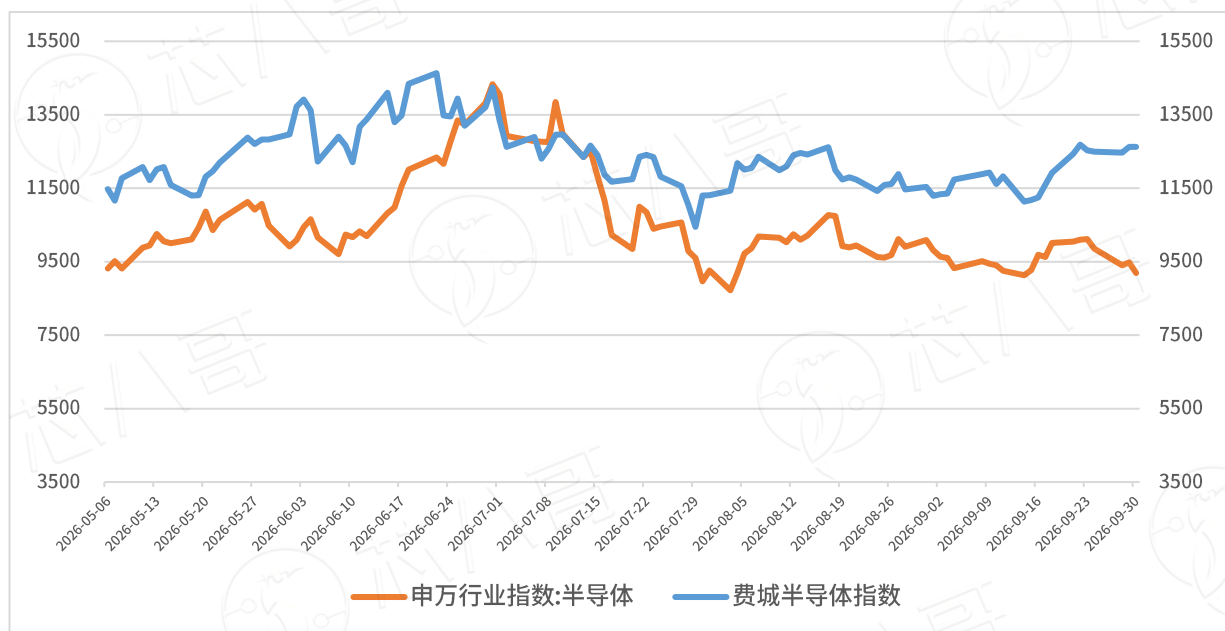
图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速



资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理

从资本市场指数来看，AI 需求强劲与宏观预期改善下，9 月费城半导体指数（SOX）上升 11.9%；受资金面、政策预期等因素影响，中国半导体（SW）业指数下滑 6.3%。

图表 6：费城及申万半导体指数走势



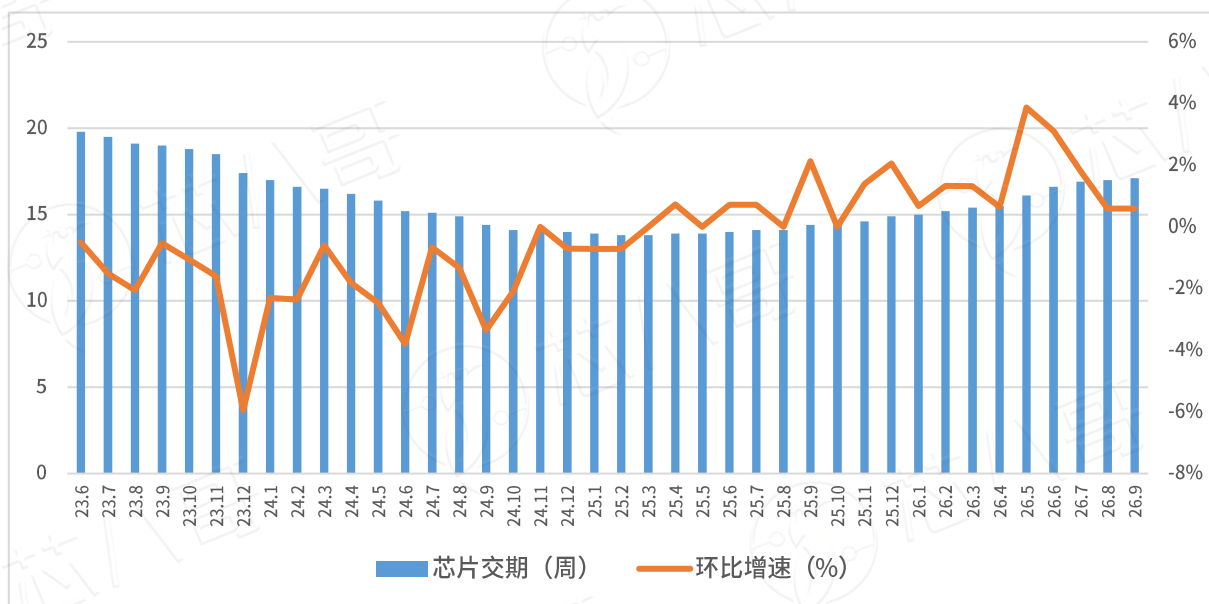
资料来源：Wind

二、芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

9 月，元器件交期连续 11 个月上升，涨价压力与供给紧张格局未见缓解。

图表 7：芯片交期趋势



资料来源：芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

9月，芯片行业量价齐升态势延续，存储、功率、模拟、MCU、FPGA、被动元件全品类涨价函密集落地，交期普遍拉长至30周以上甚至52周。AI算力需求对成熟制程产能的“虹吸效应”持续发酵，叠加8英寸产能缩减、原厂主动备货（库存目标从120天提至150天），供需刚性收紧持续。

图表 8：主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	TI	多源模拟/ 电源	16-30	16-30	延长	上升
		信号链	16-24	16-24	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
	AMS	传感器	16-40	16-40	延长	上升
	OSRAM					
	BOSCH	传感器	16-52	16-52	延长	稳定
	Diodes	多源模拟/ 电源	18-40	18-40	延长	上升
		开关稳压器	20-24	20-24	延长	上升
	FTDI Chip	接口	30-34	30-34	延长	上升
	Infineon	传感器	4-60	4-60	延长	上升
		开关稳压器	24-30	24-30	延长	上升
		汽车模拟和 电源	24-30	24-30	延长	上升
	ADI (Maxim)	信号链	26-40	26-40	延长	上升
		接口	26-40	26-40	延长	上升
		开关稳压器	26-40	26-40	延长	上升
	Microchip	信号链	4-10	4-10	稳定	上升
		定时	7-12	7-12	稳定	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关稳压器	8-16	8-16	稳定	上升
	MPS	开关稳压器	24-46	24-46	延长	上升
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-20	16-20	稳定	上升
		汽车模拟和 电源	22-24	22-24	稳定	上升
	onsemi	传感器	18-52	18-52	延长	上升
		信号链	10-16	10-16	稳定	上升
		定时	22-32	22-32	稳定	上升
		多源模拟/ 电源	14-26	14-26	延长	上升
		开关稳压器	12-22	12-22	延长	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	上升
	Renesas	信号链	14-16	14-16	延长	上升
		定时	20-26	20-26	延长	上升
		接口	12-14	12-14	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		开关稳压器	18-36	18-36	延长	上升
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	16-26	16-26	延长	稳定
	ST	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		信号链	20-22	20-22	延长	上升
		多源模拟/ 电源	18-26	18-26	延长	上升
		开关稳压器	18-26	18-26	延长	上升
		汽车模拟和 电源	18-30	18-30	延长	上升
	TE	传感器	16-52	16-52	延长	上升
	Vishay	传感器	24-52	24-52	稳定	稳定
射频 和无 线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	上升
	Microchip	WiFi 模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		蓝牙模块	12-20	12-20	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	稳定
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	延长	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	延长	稳定
	Laird	WiFi 模块	16-30	16-30	稳定	稳定
		天线	12-16	12-16	稳定	稳定
	ST	蓝牙模块	52	52	延长	上升
		收发器/接收器	30	30	延长	上升
		RFID	20	20	延长	上升
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	13	13	稳定	上升
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	上升
	onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		TVS 二极 管	16-40	16-40	延长	上升
		桥式整流器	16-20	16-20	延长	上升
		肖特基二极 管	20-50	20-50	延长	上升
		整流器	24-30	24-30	延长	上升
		开关二极管	20-50	20-50	延长	上升
		小信号 MOSFET	20-50	20-50	延长	上升
		齐纳二极管	20-50	20-50	延长	上升
		双极晶体管	20-50	20-50	延长	上升
		数字晶体管 /RETS	20-50	20-50	延长	上升
		通用晶体管	20-50	20-50	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		逻辑器件	8-44	8-44	延长	上升
	Infineon	低压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		高压 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		IGBT	12-52	12-52	延长	上升
		宽带隙 MOSFET	12-52	12-52	延长	上升
		数字晶体管 /RETS	30-52	30-52	延长	上升
		通用晶体管	30-52	30-52	延长	上升
		军用-航空 晶体管	16-24	16-24	稳定	稳定
	ST	低压 MOSFET	10-23	10-23	延长	上升
		高压 MOSFET	12-26	12-26	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		IGBT	14-24	14-24	延长	稳定
		ESD	16-24	16-24	延长	稳定
		宽带隙 MOSFET	20-32	20-32	延长	稳定
		晶闸管 /Triac	15-20	15-20	稳定	稳定
		TVS 二极 管	12-16	12-16	稳定	稳定
		整流器	18-20	18-20	延长	上升
		双极晶体管	22-36	22-36	延长	稳定
	Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	13-52	13-52	延长	上升
		ESD	52	52	延长	上升
		肖特基二极 管	16-52	16-52	延长	上升
		开关二极管	16-52	16-52	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		小信号 MOSFET	16-52	16-52	延长	上升
		齐纳二极管	16-52	16-52	延长	上升
		双极晶体管	16-52	16-52	延长	上升
		数字晶体管 /RETS	16-52	16-52	延长	上升
		通用晶体管	16-52	16-52	延长	上升
		逻辑器件	8-24	8-24	缩短	上升
MCU	Renesas	8 位 MCU	18	18	延长	稳定
		32 位 MCU	18	18	延长	稳定
		汽车	24	24	稳定	稳定
		32 位 MPU	12	12	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	40-52	40-52	延长	上升
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MCU	40-52	40-52	延长	稳定
	Infineon	8 位 MCU	10-26	10-26	稳定	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
		32 位 MCU	10-97	10-97	延长	上升
		汽车	32-45	32-45	稳定	稳定
	Microchip	8 位 MCU	4-12	4-12	稳定	上升
		32 位 MCU	4-18	4-18	延长	上升
		32 位 MPU	4-20	4-20	稳定	上升
	NXP	8 位 MCU	16-39	16-39	稳定	上升
		32 位 MCU	16-39	16-39	稳定	上升
		汽车	18-52	18-52	稳定	上升
		32 位 MPU	18-52	18-52	延长	上升
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	18-30	18-30	稳定	上升
	Intel (Altera)		14-30	14-30	稳定	稳定
	Lattice		12-36	12-36	稳定	稳定

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
	Microchip (Microsemi)		12-30	12-30	延长	上升
存储 器	Infineon	SRAM	12-52	12-52	延长	稳定
		NOR FLASH	20-26	20-26	延长	上升
	GigaDevice	NOR FLASH	16-26	16-26	延长	上升
		NAND FLASH	16-26	16-26	延长	上升
	Micron	DRAM	26-52	26-52	延长	上升
		eMMC	26-52	26-52	延长	上升
	SK Hynix	NAND flash	52+	52+	延长	上升
		eMMC	52+	52+	延长	上升
	Murata	滤波器	24-30	24-30	延长	上升

类别	供应商	产品	26.9 交期/周	26.10 交期/周	交期趋势	价格趋势
被动元件		电感/变压器	8-12	8-12	稳定	上升
		引线陶瓷电容	26-30	26-30	延长	稳定
		专用电容	20-26	20-26	延长	稳定
	TDK	滤波器	24-26	24-26	延长	上升
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	上升
		表面贴装通用陶瓷电容 (车规级)	24-26	24-26	延长	稳定

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、订单及库存情况

展望 10 月，AI 相关订单订单能见度最强，消费类下跌明显，汽车市场波动持续。

图表 9：头部企业订单及库存情况

公司	26.9 订单	26.9 库存	26.10 订单预测	26.10 库存预测
Intel	上升	低	上升	低

公司	26.9 订单	26.9 库存	26.10 订单预测	26.10 库存预测
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	上升	低	上升	低
TI	上升	较高	上升	一般
ST	上升	一般	上升	一般
ADI	上升	一般	上升	一般
Qualcomm	上升	低	上升	低
Broadcom	上升	低	上升	一般
NXP	上升	一般	上升	低
Infineon	上升	一般	上升	较低
Renesas	上升	低	上升	一般
onsemi	上升	低	上升	低
Microchip	上升	一般	上升	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低
Murata	上升	低	上升	低

公司	26.9 订单	26.9 库存	26.10 订单预测	26.10 库存预测
MTK	上升	低	上升	低

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、半导体供应链

设备和材料订单上升，代工产能分化，原厂订单回调，终端需求稳定。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

设备和材料订单延续增长态势，头部厂商需求超预期。

图表 10：半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	26.9 订单	26.9 库存	26.10 订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	上升	低	上升
	泛林	上升	低	上升
	TEL	上升	低	上升
	科磊	上升	低	上升
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升

类型	企业	26.9 订单	26.9 库存	26.10 订单预测
	新凯来	上升	无	上升
硅晶圆	信越化学	上升	低	上升
	Sumco	上升	低	上升
	环球晶圆	上升	低	上升
	台胜科技	上升	低	上升
	合晶科技	上升	低	上升
	沪硅产业	上升	低	上升

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

头部并购整合与国产突破同步加速，涨价全面落地。

图表 12：主要原厂最新动态

厂商	9 月动态
Intel	预计 2026-2028 年服务器 CPU 出货量保持双位数增长；CPU 将再涨价 10%
AMD	EPYC 服务器 CPU 与 Instinct AI 加速器订单持续放量；Q4 部分产品涨价 10%
NVIDIA	中国已重新启动 H200 订单，当前销售有限；系列 GPU 租赁价格多数上涨
TI	AI 服务器电源、工业自动化及新能源车订单快速增长
Qualcomm	与亚马逊达成数据中心基础设施合作；；发布两款服务器 SoC 芯片

厂商	9 月动态
Samsung	暂停 10 月 DDR5 报价、恢复或推迟至 11 月中旬
MTK	400G/448Gbps SerDes 研发进展顺利，预计 2027H2 准备就绪
Broadcom	2027 年人工智能营收翻倍至约 1150 亿美元
ADI	军用芯片部分型号涨幅达 30%
ST	2027 年约 80%AI 营收来自光互连相关芯片，20%来自服务器冷却和功率转换业务
Infineon	泰国工厂将投产，或成为德国、中国之后的第三大功率模块生产基地
NXP	9 月 28 日起对选定料号涨价约 10%
onsemi	10 月 10 号起部分产品涨价
Renesas	成本上涨下宣布调价
Microchip	完成对以色列边缘 AI 芯片公司 Hailo 收购
SK Hynix	DRAM 需求满足率仅 60-70%，未交付订单已顺延至 2027 年
Micron	1500 亿美元存储订单被锁定；2026 年底将 HBM 月产能提升至约 10 万片晶圆 (较 2025 年的 4-5 万片接近翻倍)
Seagate	数据中心已占公司约 90%出货量
WD	云业务占总收入比重高达 89%
Marvell	2027 财年数据中心增速预期从 50%上调至 60%

厂商	9 月动态
Wolfspeed	碳化硅功率器件在 AI 服务器电源及汽车领域需求持续增长
Murata	停产部分消费级常规、车用系列产品
Rapidus	日本政府计划提供合计超 270 亿美元资金支持
SEMCO	部分 AI 服务器直供客户价格可能上调 20%-25%
Taiyo Yuden	调价后仍无法保证原定交期
KIOXIA	目标在 2028 年将核心客户长协锁定量提升至出货量的 50%
旺宏	新增产能优先配置 NAND Flash 及利基型 eMMC
国巨	全系列电容产品产能均已售罄，新一季 MLCC 价格已生效
南亚科	增加预算加速先进制程产线建设
华邦电	11.2 亿美元并购 Infineon NOR 业务
闻泰科技	境外主体控制权受限事项处置周期拉长
豪威	存储价格上涨对部分消费电子客户的成本与机型规划形成阶段性影响
兆易创新	预计未来几年公司 DRAM 产能会呈现持续上升的态势
长鑫存储	第五代技术平台正式量产；HBM3 试产良率约 25%
长江存储	2026H1 营收 1503.1 亿元(+873.64%)、归母净利 776.05 亿元、毛利率 84.74%
江波龙	存储产业供需关系仍将维持偏紧态势

厂商	9 月动态
君正股份	今年全年存储芯片销量预计增长约 20%
中微半导体	AI、机器人、汽车电子等领域 MCU 订单回升

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

产能利用率高位，成熟制程持续涨价。

图表 12：主要晶圆代工厂最新动态

厂商	26.9 产能利用率	26.9 动态	26.10 订单预测
台积电	98%-100%	前三季度营收同比+41.1%，先进制程需求强劲；1.4nm 建厂加速，明年下半年有望量产	上升
三星	80%-90%	2027 年 HBM 将占全球 DRAM 晶圆总产能近 30%	上升
联电	85%-90%	明年价格调整幅度将比今年下半年更明显	上升
中芯国际	95%-96%	年内不降价，订单已接收到 Q4 及年底	上升
格芯	80%-90%	与 Marvell 签署多年协议	上升
世界先进	85%-95%	缺货效应将延续相当长时间	上升
力积电	80%-90%	成熟制程供不应求	上升

厂商	26.9 产能利用率	26.9 动态	26.10 订单预测
华虹	>100%	全平台订单需求持乐观态度	上升

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

订单全面上升，量价齐升态势延续。

图表 13：主要封测厂商最新动态

厂商	26.9 产能利用率	26.9 动态	26.10 订单预测
日月光	90%-95%	承接台积电 CoWoS 产能外溢	上升
台积电	100%	CoWoS-L 占比预计 Q4 升至约 75%	上升
长电科技	85%-95%	AI 服务器、智驾、AI 终端等领域订单饱满	上升
通富微电	90%-95%	高端产能持续扩充	上升
华天科技	80%-90%	整体订单保持高位饱满	上升
中小封测厂	75%-85%	受益于订单外溢与国产替代	上升

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

行业延续高景气，AI 和汽车电子成主要增长领域。

图表 14：主要元器件分销商最新动态

厂商	9 月动态
大联大	电源管理、服务器、网通设备、储能系统及高密度连接组件订单强劲
文晔科技	前三季累计营收同比+101%
Smith	中国部分服务器 CPU 价格环比涨幅超 10%
中电港	优化调整分销业务布局，看好人工智能机遇
深圳华强	MLCC 的采购需求在增加，整体交期拉长
香农芯创	委外产能能够满足客户需求
英唐智控	拟与 Synaptics 签署汽车 DDIC 等系列合作
商络电子	国产品牌收入占比提升至 55%左右
好上好	主要增长引擎仍以传统消费电子为基础
云汉芯城	上半年订单数同比+38.55%，平均订单金额从 0.37 万元提升至 0.51 万元
力源信息	AI、工业及新能源、汽车电子等业务大幅增长

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

AI 相关业务订单增长延续，工控国产替代加速。

图表 15：主要系统集成商最新动态

类别	厂商	9 月动态
消费电子	鸿海精密	9 月营收首度突破兆元，消费智能产品强劲增长
	华勤技术	积极拓展 AI 终端新品类，包括 AI PC、智能可穿戴设备等
	龙旗科技	获得全球头部客户下一代眼镜项目
	比亚迪电子	智能终端业务稳定
	立讯精密	获惠普、戴尔部分 PC 订单
	歌尔股份	战略聚焦 AI 智能眼镜为代表新兴智能硬件产品
	纬创	2026Q4 PC 出货预期将环比下滑
	仁宝	PC 需求较弱
	广达	PC 占全年营收比重可能降至低双位数
	和硕	2026Q3 出货约 130 万台，低于 Q2 的 170-180 万台
	英业达	预期 Q4 PC 出货将季减中至高个位数
汽车	博世	2026H1 智能出行业务销售额 278 亿欧元，同比-0.5%
	麦格纳	广汽欧洲车辆主要由公司代工供应
	李尔	将关闭一家热舒适系统工厂并裁员
	佛瑞亚	拟出售旗下日本子公司

类别	厂商	9 月动态
	电装	电动化仍在稳步推进
	Aumovio	完成比利时梅赫伦工厂出售；出售清洗与清洁业务
	现代摩比斯	6000 亿韩元将灯具业务出售给法国汽车零部件厂商 OPmobility
	宁德时代	稳步推进印尼工厂、匈牙利工厂及西班牙合资工厂等项目建设
	博格华纳	今年净销售额预计将达 140-143 亿美元
	奥托立夫	中国自主品牌已占中国区销售额的 55%
	采埃孚	电动卡车已占中国卡车市场约 30% 份额，预计将攀升至 50%
	安波福	上海嘉定工厂正引入具身智能机器人
	比亚迪电子	汽车业务订单增长
	德赛西威	全球化车型预计在 2027Q1 量产
	立讯精密	汽车电子受益 Leoni 整合超预期
	均胜电子	预计下半年海外地区营业收入和盈利能力有望进一步提升
	华勤技术	汽车业务短期盈利并非现阶段核心目标
	鸿海精密	9 月电动车营收新台币 11 亿元
工控	ABB	加码布局在华电气、运动控制、自动化等投资
	霍尼韦尔	中国创新中心在沪正式启用

类别	厂商	9 月动态
	西门子	筹备剥离工业转型业务板块
	施耐德	226 亿美元全现金收购工业软件巨头 PTC
	伊顿	约 8.1 亿欧元收购意大利中压配电设备制造商 COL Group
	台达电	AI 服务器相关产品营收占比超 25%
	汇川技术	大型 PLC 下游需求迫切，后续替代有望提速
	埃斯顿	国内工业机器人市场正逐步迎来价格理性回归阶段
	麦格米特	逐步完善模块—机架—整柜一体化供电方案
	埃夫特	公司的关键部件国产化率已达到 95% 以上
	信捷电气	国内大型 PLC 市场以项目型需求为主，整体保持稳健增长
新能源	阳光电源	9 月 20 日起对光伏逆变器、储能变流器及储能系统价格上调 5%-15%
	天合光能	加速布局全球 AIDC 市场
	锦浪科技	2027 年工商储、系统产品有望带动公司延续高增势头
	固德威	短期盈利增长取决于全球户储渗透率提升
	上能电气	年产 15GW 储能变流器项目建设进度约 68.51%，预计年底投产
	德业股份	储能电池包收入高速增长
	艾罗能源	针对不同海外区域供需情况动态调整产品定价

类别	厂商	9月动态
	禾迈股份	将动态调整价格策略
数据中心	鸿海精密	AI 产品拉货动能强劲
	纬创	Q4AI 相关业务仍将优于 Q3
	广达	北美 CSP 对高阶 AI 服务器需求全面爆发
	华勤技术	超节点产品的客户主要是国内头部的云服务厂商
	比亚迪电子	多款服务器已批量出货
	立讯精密	800G 光模块量产及液冷散热导入北美头部客户
通信	菲菱科思	上半年 5G 以上中高端交换机销售数量同比增长约为 182.08%
	星网锐捷	800G 数据中心交换机中国市场占有率排名第一
	共进股份	液冷服务器已实现从产线建设到规模化量产
	剑桥科技	NPO 研发进度较原计划加快

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

AI 终端与智能硬件成增长亮点，行业分化进一步拉大。

图表 16：消费电子厂商最新动态

类别	企业	9 月动态
智能手机	苹果	接受三星 2027Q1 存储报价；拟与 LG 合作推出门锁等智能家居产品
	三星	2026Q4 手机最高减产 30%
	OPPO	9 月上调多款在售机型价格
	vivo	成本压力已从新机定价蔓延至已上市机型
	小米	在售和新机型持续调价
	传音	手机提价叠加前期囤货推动盈利能力提升
PC	联想	AI PC 市场份额攀升至 25.1%，全球第一
	惠普	2026Q3 PC 出货量下降 30.9%至 1030 万台
	华硕	2026Q3 PC 出货量为 550 万台，下降 8.6%
	宏碁	存储短缺部分缓解，2027 年下半年 PC 价格或将反转
	戴尔	2026Q3 PC 出货同比下降 25%至 760 万台
VR/AR	Meta	Muse 智能体成 VR/AR 核心，AI 与硬件深度捆绑
	三星	研发带显示屏的 AI 眼镜，预计最早明年下半年发布
	苹果	仍在研发更轻薄款 Vision Pro
	INMO	完成 C 轮累计近 10 亿元，同步启动上市筹备

类别	企业	9 月动态
无人机	大疆	2026 年业绩有望同比增长 40%
	航天彩虹	生产排期已延伸至 2026 年底
	小鹏汇天	与阿联酋签署战略合作，入驻国家级监管沙盒
	极飞科技	加速拓展日本市场
电动两轮车	九号	智能电动车国内累计出货量超 1400 万台；完成东南亚市场前期调研并启动布局
	小牛电动	Q2 净亏损 1.02 亿元，单车收入降至 3029 元（同比-8.6%）
	绿源	上半年电动摩托车销量同比增长约 78.2%至约 40.2 万辆，
	雅迪	预计 Q4 行情低于预期
3C 配套产品	安克创新	战略重心聚焦充电储能、智能创新、智能影音三大核心业务方向
	绿联科技	与 WorkBuddy 开展生态合作
	海能实业	PDU 产品已经获得部分客户认可，取得小批量订单

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

中国品牌高增延续，出海与 AI 布局提速。

图表 17：新能源汽车厂商最新动态

厂商	9 月动态
比亚迪	未来 3-5 年全球新能源汽车渗透率超 50%，中国市场渗透率有望超过 80%；计划 2027 年推出固态电池车型
特斯拉	上海超级工厂 9 月交付量与国内销量均创 2026 年新高
本田	拟在 4 年内降本逾 90 亿美元，已要求供应商降价
大众	下调 2026 年营业利润率预期，原因包括中国汽车市场大幅收
宝马	计划削减 20%管理岗位
奔驰	计划削减 9.11 亿美元人力成本
丰田	计划全球工厂部署 40 万台机器人
福特	计划扩大对华合作
Stellantis	与华为、江淮洽谈玛莎拉蒂合作
通用	计划在美国本土开发电池
现代	上半年美国混动销量首次超越本田
上汽	上半年欧洲市场销量超 19 万台，全年预计可达 40 万台
雷诺	将在法国投资逾 100 亿欧元开发电车等
广汽	9 月新能源汽车销量 64231 辆（同比+50.9%）

厂商	9 月动态
长安	发布全栈自研智能辅助驾驶解决方案
吉利	规划 1.5 兆瓦公共兆瓦极充机器人
奇瑞	9 月新能源汽车销量 133,310 辆（同比+45.6%），创单月新高，连续 6 个月销量突破 10 万辆
理想	L9 月销预计 7000 台以上
零跑	第二品牌 2027Q4 亮相并交付
小米	2027 年末计划进入德国以及其余欧洲大陆国家市场
赛力斯	与华为合作模式调整
蔚来	下半年材料成本仍有继续上涨风险，预计每车可能增加 2000-3000 元
小鹏	与大众合作项目 Q3/Q4 预计每季度贡献 5-10 亿元收入
长城	维持 2026 年海外全年销售目标 70 万台

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

AI 与机器人量产成核心增量，中国厂商在全球市场份额与盈利质量同步提升。

图表 18：工控厂商最新动态

厂商	9 月动态
ABB	划两年内将中国本土生产产品贡献的销售额占比提升至 80%以上

厂商	9 月动态
西门子	与中国长三角地区百家制造企业签署合作协议；收购意大利通信巨头 MERMEC
伊顿	宣布投资 16 亿新建生产基地，扩张电气业务
施耐德	计划重组本土工业基地；宣布 11 亿元法国建厂
GE	117.5 亿美元收购精密铸造企业 CPP
台达电	子公司启动 15 亿美元海外可交换公司债计划为业务扩张备资
汇川技术	26H2 工控板块景气延续，2027 年看好市场持续增长
埃斯顿	成为首个单季度销量破万台的自主品牌
麦格米特	2026 年采购订单金额高达 83 亿元
埃夫特	2026H1 工业机器人新能源行业出货占比约 30%，同比增长超 80%；现有厂房产量提升至 1 万台/年
信捷电气	对下半年工业自动化行业需求的总体趋势保持乐观态度
雷赛智能	对下半年保持增长充满信心
英威腾	发布网络能源产品价格上调通知
宇树科技	上半年公司四足机器人全球市场份额达 37%
特斯拉	得州机器人工厂计划 2027 年计划投产，年产能目标在 1000 万台

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

行业产能出清持续，底部修复仍需时间。

图表 19：光伏厂商最新动态

厂商	9 月动态
隆基绿能	光伏行业供需矛盾仍然较为突出
天合光能	预计行业将淘汰约 20%左右的电池组件产能
通威股份	持续推进收购青海丽豪清能 100%股权
晶科能源	今年国内组件需求整体预计为 200-230GW
晶澳科技	基于量价平衡考虑，今年公司出货目标有所下修
阿特斯	行业底部修复预计仍需时间
东方日升	行业产能出清仍在持续推进
爱旭股份	济南基地首期 3GW 组件产能已全面投用
横店东磁	光伏业务保持盈利
协鑫集成	全环节价格低位运行
钧达股份	国内光伏装机需求稳步回暖

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

行业需求持续上行，厂商盈利分化。

图表 20：储能厂商最新动态

厂商	9 月动态
Fluence	全年营收预期从约 30 亿美元下调至约 24 亿美元，降幅达 20%
阳光电源	近期海外储能订单合计接近 2.6GWh
宁德时代	钠电储能订单已达 70GWh
特斯拉	2026Q3 储能部署却低于预期
阿特斯	欧美储能进口政策趋严
盛弘股份	储能订单增长良好
亿纬锂能	储能板块增长主要集中在电力储能、构网型储能及 AIDC 等新兴领域
派能科技	欧洲户用储能市场正在逐步回归更加理性的发展状态
上能电气	保加利亚布尔加斯储能电站投运，总规模 602MWh，为东欧最大储能工程
天合光能	储能行业整体呈现明确的向上趋势

资料来源：芯八哥整理

(6) 数据中心

头部云计算厂商资本支出上调，供应链订单供不应求。

图表 21：数据中心厂商最新动态

企业	9 月动态
OpenAI	预计未来五年将烧掉 2800 亿美元现金，收入增长 10 倍

企业	9 月动态
DeepSeek	前 7 个月 API 业务毛利率达 82.9%；计划 10 月底前完成第二轮 500 亿元募资
Anthropic	博通牵头银团为公司组建 600 亿美元融资
Meta	计划明年上半年部署第三代自研 AI 芯片 MTIA 450 (Arke)
Kimi	与海外云厂商分成模式正式落地
NVIDIA	拟收购开源模型初创厂商 Reflection AI
亚马逊	算力供不应求态势延续至 2027 年甚至 2028 年；正扩大 AI 服务器机柜拉货力度
甲骨文	与腾讯签署 5 年 70 亿美元算力租赁协议
微软	Azure 收入首次超 1000 亿美元（同比+43%），订单积压达 6780 亿美元
谷歌	2026 年资本支出指引上调至 1950-2050 亿美元
字节跳动	正评估将全年资本支出推至最高 700 亿美元
阿里巴巴	扩建马来西亚、德国、阿联酋、法国及中国香港数据中心
浪潮	拟定增募资不超过人民币 90 亿元用于 AI 基础设施等
戴尔	过去 12 个月累计获超 1300 亿美元 AI 服务器订单
华为	发布首个 NPO 技术昇腾 960 超节点（4096 卡/8 EFLOPS/1PB HBM）

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

运营商 5G 扩容与降本并行，中国三大运营商算力投资提速。

图表 22：通信厂商最新动态

企业	9 月动态
T-Mobile	与诺基亚达成 35 亿美元 5G 网络部署协议
AT&T	Q2 光纤及固定无线净增超 100 万创纪录
Verizon	90 亿美元成本计划推进中
Vodafone	引入外部资金继续扩展德国光纤网络
BT Group	Q3 Openreach 全光纤净增 57.1 万（+21%），FTTP 连接总数达 820 万， 渗透率超 38%
中国移动	9 月启动 AIDC 基础设施招标 27 个项目、预算约 105.79 亿元
中国联通	十五五时期预计撬动千亿级算力网投资
中国电信	9 月启动 AIDC 基础设施招标 26 个项目、预算约 16.16 亿元
中兴通讯	2026H1 数据中心产品收入同比增长超 90%
思科	2026 财年超大规模云服务商 AI 基础设施订单达 93 亿美元；计划年内完成 第三笔 AI 安全相关收购
爱立信	已将电信级 AI 模型引入无线网络，相关能力已在全球 15 家运营商部署验证
诺基亚	与微软扩大智能体 AI 运营合作

资料来源：芯八哥整理

(8) 医疗器械

巨头加速业务重组，国产龙头高端突围提速。

图表 23：医疗器械厂商最新动态

企业	9 月动态
强生	骨科业务出售，左心耳封堵业务剥离
美敦力	上调全年营收预期
西门子医疗	下调 2026 财年营收预期
波士顿科学	拟 145 亿美元收购 Penumbra
飞利浦	可孚医疗获 7 个健康监测品类的品牌授权
雅培	上半年医疗器械业务营收 113.92 亿美元（同比+11%）
GE 医疗	预计今年中国营收仍有小幅下降
迈瑞医疗	预计 2026 年全年国内业务有望转正
联影医疗	国内 5T 及以上磁共振产品收入同比增长超 50%，超高场磁共振份额保持 70%以上

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

液冷及光模块等算力供应链订单潜力巨大，关注中国电子产业最新规划。

图表 24：细分市场机会关注

机会关注	影响	涉及行业	相关企业
2026 年全球液冷市场空间约 1400-1600 亿元	液冷增长潜力巨大	液冷散热等	英维克、佳力图、高澜股份等
高盛上调 2026 年全球光模块规模至 677 亿美元	光通信供应链量价齐升延续	光模块	中际旭创、天孚通信、新易盛等
《电子信息制造业发展"十五五"规划》发布	国产替代进入规模化攻坚期	半导体等	北方华创、中芯国际及华为海思等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

GPU、MLCC 及存储等涨价态势延续。

图表 25：细分市场风险预警

风险预警	影响	涉及行业	相关企业
NVIDIA 系列 GPU 租赁价格多数上涨	算力供需缺口仍存	GPU 等	NVIDIA、AMD 及华为海思等
村田停产部分消费级常规、车用系列产品	中高端 MLCC 涨价预期延续	MLCC	Murata、SEMCO 及 TDK 等
NOR Flash 高容量 2026H2 价格或翻倍	利基存储涨价持续	功率器件	兆易创新、华邦电及旺宏等
三星电子、SK 海力士内存库存已不足 10 天	存储量价齐升延续	存储	Samsung、SK Hynix 及 Micron 等

资料来源：芯八哥整理

六、小结

9 月，AI 算力全面加速，涨价潮向全链扩散，消费端承压持续，各行业分化加剧。功率/MCU/模拟/被动件等涨价全面落地，交期普遍拉长至 30 周以上，交期延长从消费级蔓延至车规、工业级核心料号。

展望年底，AI 相关订单延续强劲增长，但需重点关注消费和汽车订单波动，消费电子涨价—砍单的恶性循环已形成，谨慎评估对消费类客户，严控账期与库存。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

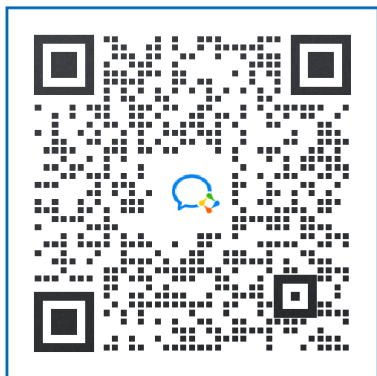
华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2026 年 10 月



扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、厂商动态和行业趋势报告



加入芯八哥半导体行业交流群

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、行业白皮书免费领取

华强电子网集团是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网 B2B 综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以“线上+线下”相结合的 B 端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的**全球采购服务**和**综合信息服务**，致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业链交易效率和客户服务水平的提升。

未来，华强电子网集团将通过与物流、资金流、信息流以及自身优势多元产业链的深层次合作和优势互补，围绕电子元器件及相关产品垂直应用领域，通过不断创新服务内容，进一步构建多层次、满足长尾采购需求的现货大生态，致力于打造世界级的电子元器件产业互联网平台。





华强电子网集团
Huaqiang Electronic Network Group



芯/八哥

电子元器件产业互联网平台

www.hqengroup.com



更高效 更透明 重构产业生态

元器件采购 | 产品信息展示 | 仓储服务 | BOM工具
品牌推广 | SaaS | PCB制板